

中国国际金融股份有限公司

关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司

2024年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”或“芯源微”）持续督导工作的保荐机构，承担公司持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作计划制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与芯源微签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2024 年度，芯源微未发生保荐机构按有关规定必须公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内，向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2024 年度，芯源微未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解芯源微经营情况，对芯源微开展持续督导工作

序号	工作内容	实施情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2024 年度，保荐机构督导芯源微及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促芯源微依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对芯源微的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，2024 年度，芯源微的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促芯源微严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对芯源微的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	芯源微无控股股东、实际控制人，2024 年度，芯源微董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	芯源微无控股股东、实际控制人，2024 年度，芯源微不存在未履行承诺的情况

序号	工作内容	实施情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2024 年度，经保荐机构核查，芯源微不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2024 年度，芯源微未发生该等情形
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2024 年度，芯源微不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）经营风险

1. 下游客户扩产不及预期或产能过剩的风险

半导体设备行业受下游半导体市场及终端消费市场需求波动的影响较大，如果终端消费市场需求尤其是增量需求下滑或由于快速扩张导致的产能过剩，半导体制造厂商可能会削减资本性支出规模，将会对包括公司在内的半导体设备行业

企业的经营业绩造成较大不利影响。

2. 研发投入可能大幅增长的风险

随着公司对新产品、新技术研发的持续投入以及可能承担重大科研项目，未来公司研发投入可能会出现阶段性的大幅增长，不排除对公司的经营业绩造成一定冲击。

3. 供应商供货不稳定或成本提升风险

半导体设备属于高精密的自动化装备，研发和生产均需使用高精度元器件，对产品机械结构的精度和材质要求较高，而我国与此相关的产业配套环境依然不够成熟，部分关键零部件仍然有赖于进口。公司虽与上游供应商建立了长期稳定的合作关系，但不排除因少数国家持续滥用出口管制措施或者关税壁垒，导致相关物料供应受阻或成本提升，或未来下游半导体制造业对半导体设备需求出现爆发式增长从而对上游供应商的重要物料短期内造成挤兑，最终对公司产品生产造成一定的压力。

4. 产品商业化推广不及预期的风险

作为半导体产线上唯一与光刻机联机作业的核心工艺设备，公司核心产品前道涂胶显影机机械结构及软件调度复杂、工艺验证难度高、成熟化周期长。近年来，虽然公司在该领域产品研发及客户导入取得了一定成绩，成功在下游客户端占据一席之地，但该细分赛道仍然被日本厂商高度垄断，技术壁垒极高。与此同时，国际主流光刻机在产能效率及精度指标等方面也在持续提升，对与之配套的涂胶显影机的研发迭代提出了更高的要求，不排除公司在该领域产品后续商业化推广不及预期的风险。此外，公司目前已陆续推出了包括前道化学清洗机、临时键合机、解键合机、全自动 SiC 划裂片一体机等在内的多款新产品，截至报告期末，上述新产品仍处于商业推广初期，尚未形成大规模销售，如果未来商业化推广不及预期，不排除会对公司业绩产生较大不利影响。

（二）财务风险

1. 应收账款回收风险

公司应收账款占流动资产的比重较大，虽然公司主要客户的历史信用状况良好，应收账款发生坏账的可能性较小，但一旦客户的财务状况恶化或信用状况发生重大变化，公司未来的生产经营及偿债能力仍可能受到不利影响。

公司已严格依据企业会计准则要求评估应收账款信用风险并计提减值损失准备，未来将进一步加强对客户资信情况的调查和分析，严格按合同组织生产和销售，强化应收账款监督考核，健全销售回款责任制、呆坏账损失核销制，以确保公司整体信用风险处于可控范围内。

2. 存货跌价风险

公司的存货风险主要为未来下游行业需求发生重大变化或者其他难以预料的情况出现，导致存货无法顺利消化并出售，可能对公司的经营业绩及经营现金流产生不利影响。公司已制定了完善的存货管理制度并有效执行，未来将密切关注下游需求变化，降低产品库存风险。

3. 税收优惠风险

报告期内，公司享受的税收优惠政策包括软件产品增值税即征即退、研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法享受相关税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。

4. 政府补助政策风险

报告期内，公司非经常性损益中计入当期损益的政府补助的金额为 1.37 亿元，占当期利润总额的比例为 60.94%。如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱，公司取得的政府补助金额将会有所减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（三）行业风险

1. 市场竞争加剧的风险

作为与光刻机配合进行作业的关键处理设备，公司生产的涂胶显影设备成功打破国外厂商垄断并填补国内空白，其中在集成电路制造后道先进封装和 LED 芯片制造等环节，作为国内厂商主流机型已成功实现国产替代，伴随着半导体产业市场竞争愈发激烈，如果未来有更多的半导体设备制造企业生产同类型设备，或采取恶性竞争的策略，则可能会导致公司未来客户流失、市场地位和经营业绩下滑，从而对公司持续经营能力产生不利影响。

2. 国际贸易摩擦加剧的风险

随着国际贸易不确定性的增加，不排除相关国家贸易政策变动影响公司上游供应商的供货稳定性。

（四）宏观环境风险

半导体设备行业受下游半导体市场及终端客户市场需求波动的影响较大，其发展呈现一定的周期性，如果未来宏观经济发展乏力，终端客户市场需求恢复不及预期，半导体制造厂商将会减少半导体设备的采购，行业将面临一定的波动风险。

四、重大违规事项

2024 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元			
主要会计数据	2024 年	2023 年	本期较上年同期增减（%）
营业收入	175,360.60	171,696.99	2.13
归属于上市公司股东的净利润	20,281.20	25,062.62	-19.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,330.66	18,716.52	-60.83
经营活动产生的现金流量净额	44,180.94	-56,287.67	不适用
主要会计数据	2024 年末	2023 年末	本期末较上年末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	269,112.74	238,044.03	13.05
总资产	559,687.32	430,155.56	30.11
主要财务指标	2024 年	2023 年	本期较上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	1.01	1.82	-44.51
稀释每股收益（元/股）	1.01	1.82	-44.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.37	1.36	-72.79
加权平均净资产收益率（%）	8.10	11.24	减少 3.14 个百分点

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期较上年 同期增减 (%)
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	2.93	8.40	减少 5.47 个百分 点
研发投入占营业收入的比例 (%)	16.92	11.52	增加 5.40 个百分 点

公司 2024 年度主要财务数据及财务指标的变动原因如下：

1. 归属于上市公司股东的净利润同比下降 19.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 60.83%，主要原因是：（1）报告期内公司持续加大研发投入力度，研发投入增加；（2）随着公司规模的不不断扩大，成本费用增加；（3）报告期内计入其他收益的政府补助增加。
2. 经营活动产生的现金流量净额同比由负转正增加 100,486.61 万元，主要原因是：（1）报告期内销售回款增加；（2）公司积极调整付款信用政策，采购付款有所减少；（3）报告期内公司收到的税费返还及政府补助有所增加。
3. 基本每股收益、稀释每股收益同比下降 44.51%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 72.79%，主要原因是：（1）报告期内公司净利润有所下降；（2）公司实施股权激励及 2023 年年度权益分派，总股数增加。

六、核心竞争力的变化情况

（一）持续丰富的产品线布局

公司是国内涂胶显影、单片式湿法设备龙头企业，近年来，公司在不断巩固主业市场优势的同时，陆续推出了多款重要设备。2023 年，公司临时键合、解键合设备获得了多家大客户订单，2023 年 9 月，公司广州子公司正式成立，致力于光刻胶泵等核心零部件的研发和产业化，2024 年 3 月，公司正式发布了前道化学清洗机、全自动 SiC 划裂片一体机两款全新设备，公司产品线持续丰富。

公司已形成了前道涂胶显影设备、前道清洗设备、后道先进封装设备、化合物等小尺寸设备四大业务板块，产品已完整覆盖前道晶圆加工、后道先进封装、化合物半导体等多个领域。

（二）优秀的研发技术团队与核心管理团队

公司建有较为完善的人才培养体系，通过承担国家重大专项及地方重大科研任务、开展专题技术培训等方式培养了半导体设备的设计制造、工艺制程、软件开发与应用等多种学科人才。公司重视技术人才队伍的建设，积极引进了一批具有丰富的半导体设备行业经验的高端人才，形成了稳定的核心技术人才团队，能紧密跟踪国际先进技术发展趋势，具备较强的持续创新能力。

公司核心管理团队人员稳定，具有丰富的管理经验，对行业的发展趋势和竞争格局有深入的了解，且均在公司服务多年，为公司后续的稳健经营、良性发展打下了基础，是公司快速稳定发展的重要因素。中层骨干干部年龄结构合理，梯队建设良好，在市场、生产、研发等各重要岗位都具有兼具经验和事业热情的专业领军人物。

在员工培养方面，公司自上市以来先后推出了三期限制性股票激励计划，共激励对象 336 人次，被激励员工均为公司管理层及核心业务骨干，股票激励计划明确了公司业绩考核目标，充分调动核心员工的积极性和主动性，力争在公司内部培养一批优秀的管理和技术人才。

（三）丰富的技术储备

公司高度重视新技术、新产品和新工艺的研发工作，报告期内，公司研发支出 2.97 亿元，占营业收入的 16.92%。通过多年的技术积累以及承担国家 02 重大专项，公司已经成功掌握包括涂胶显影设备、单片式湿法设备等产品多项核心技术，并形成了完善的自主知识产权。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司共获得专利授权 332 项，其中发明专利 199 项（其中中国大陆地区发明专利 178 项，中国台湾地区发明专利 18 项，美国发明专利 3 项），实用新型专利 95 项，外观设计专利 38 项；拥有软件著作权 96 项。

（四）优质的客户资源

公司以沈阳为销售总部，并在苏州、昆山、武汉、上海等地设有办事处，销售网络覆盖长三角、珠三角及中国台湾地区等产业重点区域，建立了快速响应的

销售和技术服务团队。

2021 年，公司控股子公司“上海芯源微企业发展有限公司”在上海自由贸易试验区临港新片区注册成立。上海已成为全球集成电路产业投资最具吸引力的地区之一，公司上海子公司的建设，将实现公司三“靠近”的初衷——“靠近客户”、“靠近人才”、“靠近供应链”，是公司加快发展的重要里程碑。2023 年 9 月，公司控股子公司广州芯知在广州市成立，完善了公司在粤港澳大湾区区域的战略布局。

（五）较为突出的行业地位

公司是国家集成电路产业技术创新联盟及集成电路封测产业链技术创新战略联盟理事单位，先后主持制定了喷胶机《喷雾式涂覆设备通用规范》（SJ/T11576-2016）、涂胶机《旋转式涂覆设备通用规范》（SJ/T11183-2022）两项行业标准，均已正式颁布实施。

2023 年，公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”，国家企业技术中心的认定，是对公司技术创新能力和自主研发能力的充分肯定，也是公司科研能力和综合能力的体现。成立至今，公司先后获得“全国第一批专精特新‘小巨人’”、“国家级知识产权优势企业”、“国家高技术产业化示范工程”、“国家级企业技术中心”、“国内先进封装领域最佳设备供应商”、“辽宁五一劳动奖状”、“第六届全国专业技术人才先进集体”、“全国五一劳动奖状”等多项殊荣，公司产品先后获得“国家战略性创新产品”、“国家重点新产品”、“辽宁省科学技术进步一等奖”、“辽宁省制造业单项冠军产品”等多项荣誉，充分体现了公司的技术水平和管理能力，奠定了公司在细分行业内的突出地位。

（六）高效的质量管控与服务保障能力

公司自成立以来一直专注于半导体专用设备的研发、生产和销售，以高效的质量管控、全面优质的客户服务以及快速灵活的售后响应赢得市场。公司坚持“质量为上”的经营理念，建立了完善的质量控制制度，实行严格的质量控制手段，以保证产品质量的稳定性和一致性。目前公司应用于集成电路制造后道先进封装领域的喷胶机、涂胶/显影机和清洗机等产品已通过 SEMI S2 国际安规认证，为公司进入国际半导体设备供应商体系奠定了良好的基础。同时公司坚持以用户需

求为中心，高度重视客户服务能力建设，已形成对客户需求的快速反应机制，以保证及时、迅速、有效地解决客户在产品后续使用过程中遇到的相关问题。此外，公司研发人员会定期进行客户拜访以收集产品需求，并根据客户及市场需求进行产品的升级或更新换代，以保持产品的持续竞争力。

（七）完善的供应链

半导体设备属于高精密的自动化装备，研发和生产均需使用大量的高精度元器件，对产品机械结构的精度和材质要求也很高。经过多年的沉淀，公司与国内外供应商建立了较为稳定的合作关系，培育与建设成了较为完善的原材料供应链，有利于保证公司产品原料来源的稳定性及可靠性。公司提前布局上游零部件国产替代，对国内供方进行长期培养和扶持，报告期内成功实现了多种泵类零部件的国产替代。报告期内，公司通过批采谈判、年度框架合同等商务方式有效降低了整体采购成本。

2022年8月，公司全资子公司 Kingsemi Kyoto 株式会社（后更名为“Kingsemi Japan 株式会社”）在日本京都正式设立。日本子公司的设立，有助于公司深入对接日本在泛半导体领域的高端产业及研发资源，增强公司在设备及关键零部件领域的技术实力。同时，还可借助境外丰富的供应链资源，寻找更为可靠、更具性价比的原材料采买渠道，降低产品生产成本，增强产品整体竞争力。

综上所述，2024年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发投入情况

2024年度，公司研发投入总金额 29,665.31 万元，较上年同期增长 49.93%；2024 年度研发投入占营业收入的比例为 16.92%，较上年同期增加 5.40 个百分点。

（二）研发进展

截至 2024 年 12 月 31 日，公司共获得专利授权 332 项，其中发明专利 199 项（其中中国大陆地区发明专利 178 项，中国台湾地区发明专利 18 项，美国发明专利 3 项），实用新型专利 95 项，外观设计专利 38 项；拥有软件著作权 96

项。

2024 年度及截至 2024 年末，公司专利情况具体如下：

专利类型	本期新增		累计数量	
	申请数（项）	获得数（项）	申请数（项）	获得数（项）
发明专利	74	19	564	199
实用新型专利	36	28	176	95
外观设计专利	3	2	40	38
软件著作权	12	18	97	96
合计	125	67	877	428

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和节余情况如下：

1. 2019 年首次公开发行股票募集资金

2024 年度，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）归还闲置募集资金暂时补充流动资金 54,000,000.00 元；（2）超募资金永久补充流动资金 38,300,000.00 元；（3）超募资金回购股份 10,009,160.24 元。2024 年度公司累计使用募集资金 48,309,160.24 元，支付银行手续费（不含增值税）415.00 元，募集资金专用账户利息收入为 13,796.15 元，募集资金专用账户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 5,708,398.23 元。具体明细如下：

单位：人民币元

项目	累计金额
募集资金净额	505,744,103.78
减：截至 2024 年 12 月 31 日直接对募集资金项目投入	387,316,021.56
其中： 高端晶圆处理设备产业化项目	248,133,621.56
高端晶圆处理设备研发中心项目	139,182,400.00
减：截至 2024 年 12 月 31 日使用超募资金永久补充流动资金	114,900,000.00
减：截至 2024 年 12 月 31 日使用闲置资金暂时补充流动资金	244,000,000.00
减：截至 2024 年 12 月 31 日节余募集资金补流	9,284,650.48
减：截至 2024 年 12 月 31 日使用超募资金回购股份	10,009,160.24
加：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金理财收益	11,579,663.95
加：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金利息收入扣除手续费净额	10,245,640.65
加：截至 2024 年 12 月 31 日归还暂时补充流动资金	244,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	6,059,576.10
减：股份回购剩余资金尚未转回部分	351,177.87
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	5,708,398.23

2. 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

2024 年度，公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况为：

（1）对募集资金项目投入 72,178,850.59 元，其中：上海临港研发及产业化项目 72,147,650.59 元，高端晶圆处理设备产业化项目（二期）31,200.00 元；（2）使用节余募集资金补充流动资金 10,679,597.56 元。2024 年度公司累计使用募集资金 82,858,448.15 元，支付银行手续费（不含增值税）898.33 元，募集资金专用账户利息收入为 981,026.79 元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品所得投资收益 5,674,115.03 元，募集资金专用账户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 241,129,893.53 元。具体明细如下：

单位：人民币元

项目	累计金额
募集资金总额	999,999,928.71
减：截至 2024 年 12 月 31 日直接对募集资金项目投入	778,436,397.58
其中：临港研发及产业化项目	472,146,852.90
高端晶圆处理设备产业化项目（二期）	3,477,497.24
补充流动资金项目	302,812,047.44
减：截至 2024 年 12 月 31 日用于现金管理的暂时闲置募集资金	0.00
减：截至 2024 年 12 月 31 日节余募集资金补流	10,679,597.56
加：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金理财收益	24,192,371.56
加：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金利息收入扣除手续费净额	6,053,588.40
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	241,129,893.53

（二）募集资金存储情况

1. 2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中信银行沈阳和平支行	8112901012900643057	已销户
中国建设银行沈阳城内支行	21050139000800001255	已销户
招商银行沈阳浑南西路支行	124904600110111	5,708,398.23
合 计		5,708,398.23

2. 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中信银行沈阳南站支行	8112901011100849786	241,101,048.01
招商银行沈阳浑南西路支行	124904600110858	28,845.52
平安银行沈阳分行	15912666666677	已销户

银行名称	银行帐号	余额
招商银行上海自贸区临港新片区支行	121942302510107	已销户
	12194230257100017	已销户
	12194230257100020	已销户
合 计		241,129,893.53

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）持股情况

公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高级管理人员直接持有的公司股份情况如下：

单位：股

姓名	职务	2023 年末 持股数量	2024 年末 持股数量	股份增减 变动	持股变动原因
宗润福	董事长、总裁、 核心技术人员	2,435,273	3,231,146	795,873	公司权益分派实施 及二级市场交易
郑广文	董事	0	0	0	不适用
胡琨元	董事	0	0	0	不适用
赵庆党	董事（离任）	0	0	0	不适用
黄鹤	董事	0	0	0	不适用
孙华	董事	0	0	0	不适用
陈兴隆	董事、副总裁、 核心技术人员	107,692	199,073	91,381	公司权益分派实施 及股权激励归属
朱煜	独立董事	0	0	0	不适用

姓名	职务	2023 年末 持股数量	2024 年末 持股数量	股份增减 变动	持股变动原因
宋雷	独立董事	0	0	0	不适用
钟宇	独立董事	0	0	0	不适用
梁倩倩	监事	0	0	0	不适用
史晓欣	监事	0	0	0	不适用
孙东丰	职工代表监事	38,480	55,796	17,316	公司权益分派实施
李风莉	副总裁（离任）	1,245,050	1,848,243	603,193	公司权益分派实施 及股权激励归属
顾永田	副总裁	125,702	136,738	11,036	公司权益分派实施 及二级市场交易
汪明波	副总裁	59,718	64,986	5,268	公司权益分派实施 及二级市场交易
崔晓微	副总裁	127,058	138,176	11,118	公司权益分派实施 及二级市场交易
张新超	财务总监	8,880	30,160	21,280	公司权益分派实施 及股权激励归属
程虎	副总裁、核心技术 人员	44,400	85,898	41,498	公司权益分派实施 及股权激励归属
刘书杰	董事会秘书	0	40,890	40,890	公司权益分派实施 及股权激励归属
合计	-	4,192,253	5,831,106	1,638,853	-

截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高级管理人员所持有的公司股份均不存在质押、冻结的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，公司不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

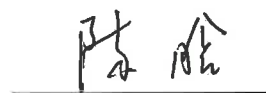
（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



王煜忱



陈 晗

